LAGENAUFBAU HDI (Standard)

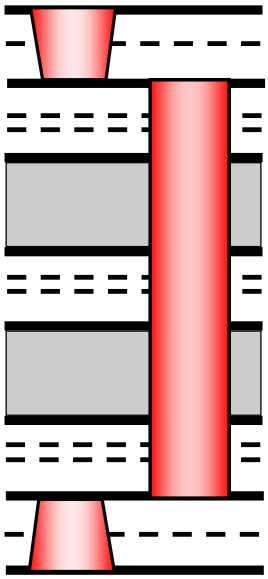
HDI08_1+6b+1_1,60_35

8 - Lagen

Kerne: 0,41 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 6B + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	9 µm		**30**	
					2 x 1080	**132**	
3	2			35 µm		**33**	
			0,410 mm			**410**	
4	3			35 µm		**33**	
					2 x 2116	**210**	
5	4			35 µm		**33**	
			0,410 mm			**410**	
6	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**132**	
7	RSK1		Folie	9 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
8	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Endkupferdicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1630

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,60**	+/-	0,14	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,69	+/-	0,17	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,75	+/-	0,19	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	13+